

新製品

Twin-air®

独自の特許技術 ツインエア方式
高精細ディスペンサ搭載

塗布・描画システム

*Twin Pneumatic High-definition Liquid Dispensing System
with Top & Side View Optics*

～R&Dから量産用途まで、RDXシリーズ～

①ワーク形状に合わせて3次元塗布補正

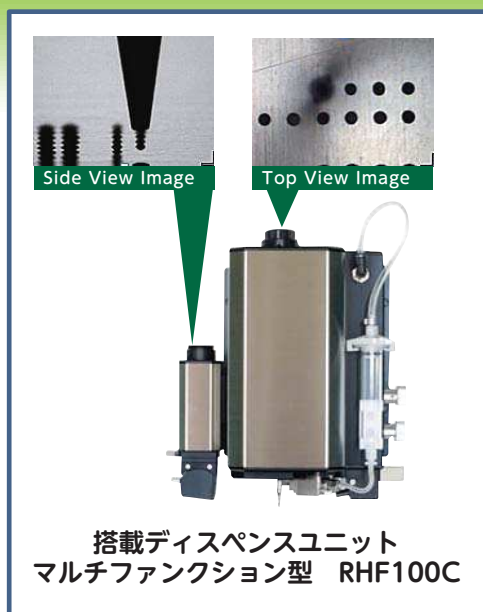
カメラとレーザー変位計でワークを計測、補正しながら塗布を行います
パターンマッチングによるX-Y-θアライメント機能付

②データインポート機能

dxfファイルを読み込み、自動で塗布データを追加します

③高精度・高剛性

Twin-air®の微細・高精度塗布能力を最大限引き出します



RDX-500V2,
RDX1000-V2



RDX3000-V2H

エンジニアリングシステム株式会社

ESCO
エンジニアリングシステム株式会社

RDX シリーズ 特長と商品ラインナップ

■マルチファンクションディスペンスユニットを搭載

- ・吐出性能はそのままに、リアルタイムでノズル直上からの観察可能(トップビュー光学系)
- ・トップ・サイドビュー光学系で、吐出状態をリアルタイムで観察
- ・トップビュー光学系で、アライメント、画像処理計測が可能

■特許技術ツインエア方式

セルフサックバック技術で従来のエア式の問題点を液ダレ・液玉・濡れ上がり・糸引き、サテライト発生を防止

■RDX専用の塗布・描画アプリケーション・ソフトウェア

- ・レーザー変位計、トップビューカメラにより3次元での塗布位置の補正が可能
- ・塗布形状データ(dxfファイル)のインポートが可能(dxfファイルのバージョンによる)
- ・X-Y-Zの3軸補間運転が可能
- ・簡易計測機能付き

仕 様	R&D用システム RDX500-V2	R&D用システム RDX1000-V2	高精度システム RDX3000-V2H
ディスペンサ方式	ツインエア方式	ツインエア方式	ツインエア方式
搭載ディスペンスユニット	RHF100C	RHF100C	RHF100C
最大速度(mm/s)	XY:50 Z:30	XY:100 Z:30	XYZ:100
搭載可能基板サイズ	最大150mm	最大150mm	最大300mm(ウエハは200mm)
X-Y有効ストローク範囲	50×50mm	100×100mm	300×300mm
基板固定方法	多孔質吸着パッド(変更可能)	多孔質吸着パッド(変更可能)	多孔質吸着パッド(変更可能)
ソフトウェア	専用アプリケーションソフトウェア	専用アプリケーションソフトウェア	専用アプリケーションソフトウェア
外形サイズ(mm)、重量	W600×D750×H850 180kg以下	W600×D750×H850 180kg以下	W830×D1045×H1560 1000kg以下
特長	R&D用途に最適な卓上型システム。 X-Yステージに多孔質吸着テーブルを搭載、様々ワークの真空吸着が可能。 RHF100Cを搭載することで、直上からの正確な顕微鏡アライメントを実現。	R&D用途に最適な卓上型システム。 X-Yステージに多孔質吸着テーブルを搭載、様々ワークの真空吸着が可能。 RHF100Cを搭載することで、直上からの正確な顕微鏡アライメントを実現。	高精度X-Yステージを搭載。8インチのシリコンウエハへの正確な塗布・描画が可能 オプション ・ウエハ搬送ユニット ・ノズル洗浄ユニット ・ノズル位置補正ユニット



株式会社 日本レーザー

http://www.japanlaser.co.jp | mail to: proc@japanlaser.jp

東京本社 東京都新宿区西早稲田2-14-1

TEL 03-5285-0861 FAX 03-5285-0860

大阪支店 大阪市東淀川区東中島1-20-12

TEL 06-6323-7286 FAX 06-6323-7283

名古屋支店 名古屋市中区錦3-1-30

TEL 052-205-9711 FAX 052-205-9713

デモ・評価・試作等を承っておりますので、お気軽にお問合せください。

エンジニアリングシステム株式会社
http://www.engineeringsystem.co.jp



〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83

TEL 0263-26-1212 FAX 0263-26-1213

E-mail: sales@engineeringsystem.co.jp